

# 从0开始教你学 STM32

赵星寒 编著



北京航空航天大学出版社  
BEIHANG UNIVERSITY PRESS

# 从 0 开始教你学 STM32

赵星寒 编著

北京航空航天大学出版社

## 内 容 简 介

本书以引导读者快速全面掌握 STM32 系列嵌入式微控制器为目的,由浅入深地带领大家进入 STM32 的世界。本书详细介绍了 STM32F103 最小系统、寄存器及存储器、最小系统管理、中断和事件、汇编语言编程方法、汇编语言工程项目、Thumb-2 指令集、伪指令、C 语言编程方法、混合编程方法、通用外部端口 GPIO 和复用外部端口 AFIO、模拟/数字转换器 ADC、通用异步同步收发器 USART 等。

本书非常适合 STM32F10x 嵌入式微控制器的初学者,以及有一定嵌入式应用基础的电子工程技术人员参考,也可作为高等院校电子信息、自动控制等专业的教学和科研开发参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

从 0 开始教你学 STM32 / 赵星寒编著. -- 北京 : 北京航空航天大学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5124 - 1567 - 6

I. ①从… II. ①赵… III. ①微控制器 IV.  
①TP332. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 170812 号

版权所有,侵权必究。



从 0 开始教你学 STM32

赵星寒 编著

责任编辑 潘晓丽 刘秀清 张雯佳

\*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(邮编 100191) <http://www.buaapress.com.cn>

发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82328026

读者信箱: emsbook@gmail.com 邮购电话:(010)82316524

北京楠海印刷厂印装 各地书店经销

\*

开本: 710 × 1 000 1/16 印张: 18 字数: 384 千字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷 印数: 3 000 册

ISBN 978 - 7 - 5124 - 1567 - 6 定价: 39.00 元

# 前言

我学过和使用过很多种微处理器,但还是对 STM32 系列情有独钟,在应用了几次这种芯片之后,很想向广大初学者推荐这个系列产品。

STM32 系列是一款以 ARM 为核的微处理器系列,其内核是高档的 ARM Cortex-M3 体系结构。STM32 系列微处理器成员比较多,既包含高性能外围复杂的芯片,也包含高性能小封装的芯片,其中小封装的芯片以价格低廉、性能优良而著称,在很多场合可以替代高端的单片机。

学习这个系列的微处理器,对于初学者建议如下。

## 1. 使用寄存器编程方法,而不是函数库编程方法

STM32 系列软件编程有两种方法:一种是传统的编程方法,称为寄存器方法,就是学习使用微处理器的寄存器,并通过对寄存器的操作实现编程;另一种称为函数库方法,就是使用厂家提供的函数库编程,这种方法不需要学习微处理器的寄存器。

之所以推荐使用寄存器方法,主要原因如下:

① 寄存器编程方法是普遍应用的方法。这种编程方法,对所有微处理器都适用,因此学会这种方法对学习其他微处理器会有所帮助;而函数库编程方法只是针对这一系列微处理器适用,对学习其他微处理器则没有帮助。

② 寄存器编程方法是一种底层的、与硬件相关的方法。在使用中需要对微处理器的硬件和寄存器进行认真的学习,有助于了解各种微处理器及其应用;而即使能够很熟练地应用函数库方法,也无法了解微处理器的细节,对深入学习没有多大帮助。

③ 如果对微处理器的寄存器了解不够,那么在使用函数库方法时遇到困难就无法解决。

总之,寄存器编程方法是最基本的方法,具有普遍性,因此本书建议初学者从学习这一方法出发,以 STM32 微处理器为入门芯片,开始学习微处理器的应用,特别是 ARM 系列微处理器的应用。

## 2. 学习微处理器,重要的是实践,因此需要找一套仿真环境软件

仿真环境建议使用 Keil 公司的  $\mu$ Vision,或者称为 RealView,这套软件易于学

## 前 言

习,一般试用版也较易获得。在这个环境中,可以编辑、编译C语言和汇编语言源程序,也可以仿真调试程序,提高自己的实战水平。

在使用时,注意需要正确设置环境。

### 3. 如果熟悉了上述仿真软件,还需要找一套仿真器

现在,一套STM32的仿真器价格很低,这是学习的基础。一般情况下,STM32芯片的仿真器可以仿真很多芯片,因此还会有很多其他用途。仿真器都是JTAG接口的,结构简单。

### 4. 实验产品或实验板

自己可以提出一个目标产品作为学习实验使用,目标产品不要太复杂,从原理设计到PCB板制作,从焊接到调试,完成一个完整的研究过程,对学习是十分有帮助的;也可以自己购买一块实验板,这样成本会低一些,购买实验板时,建议只购买最简单的实验板,这样的实验板上只有一片STM32芯片,不需要其他外部附件。

在这个实验板的基础上,飞线连接一些基本部件,比如键盘、LED管,使用电位器为A/D实验提供信号源、外部开关等,非常简单而实用。

如果有问题需要讨论,请按照下列地址与作者联系:zxhjeket@aliyun.com。

感谢我的同事郑玉峰、周春来、刘晓波、赵丽、孙蓬蛟、王庚兰、赵泽以及我的朋友吴乌恩、程宁等的支持。

赵星寒

2014年7月于北京



# 录

第 1 章 概述	1
1.1 STM32F1xx 系列概述	1
1.1.1 STM32F1xx 的多个子系列	1
1.1.2 STM32F1xx 系列特点	2
1.1.3 内核简介	3
1.2 封装	3
1.3 接口	4
1.4 选型指南	5
1.5 开发环境	7
第 2 章 STM32F103 最小系统	9
2.1 最小系统设计	9
2.1.1 最小系统	9
2.1.2 电源	10
2.1.3 复位控制	11
2.1.4 系统启动模式	12
2.1.5 振荡器	12
2.2 JTAG 接口	13
第 3 章 寄存器及存储器	14
3.1 内部通用工作寄存器	14
3.2 STM32F1xx 存储器空间	19

# 目 录

3.2.1 存储器映像.....	19
3.2.2 外设管理寄存器.....	20
3.2.3 内嵌 Flash 存储器 .....	22
3.2.4 内嵌 SRAM 存储器 .....	23
3.2.5 系统存储器.....	23
3.3 堆栈及栈区.....	24
3.4 数据格式.....	25
3.4.1 数据的大端和小端.....	25
3.4.2 地址对准.....	26
3.5 位段(bit-banding)操作 .....	28
3.5.1 位操作概念和位操作分区.....	28
3.5.2 位段操作.....	30
3.5.3 位段操作应用举例.....	32
<b>第 4 章 最小系统管理 .....</b>	<b>36</b>
4.1 电源系统管理.....	36
4.1.1 电压监测器 PVD .....	37
4.1.2 低功耗模式.....	38
4.1.3 实时时钟的自动唤醒 AWU 方式 .....	40
4.1.4 电源控制寄存器组介绍.....	41
4.2 复位系统.....	42
4.2.1 系统复位.....	43
4.2.2 系统复位源的识别和应用.....	44
4.2.3 外部设备复位.....	46
4.3 时钟系统管理.....	49
4.3.1 独立看门狗(IWDG)时钟 .....	50
4.3.2 实时时钟 RTC .....	51
4.3.3 系统主时钟.....	53
4.3.4 外部设备时钟.....	59
4.3.5 输出时钟源.....	62
4.3.6 时钟管理寄存器组 .....	63

第 5 章 中断和事件 .....	66
5.1 中断和事件概述 .....	66
5.2 中断向量表 .....	68
5.3 内核中断 .....	70
5.3.1 内核中断介绍 .....	71
5.3.2 内核中断的应用 .....	71
5.3.3 内核中断的管理 .....	72
5.4 外部中断/事件 .....	75
5.4.1 外部中断/事件概述 .....	76
5.4.2 外部中断/事件管理 .....	78
5.5 外设中断 .....	81
5.5.1 外设中断概述 .....	82
5.5.2 系统中断设置/使能寄存器 .....	82
5.6 中断优先权和中断过程 .....	84
5.6.1 中断优先权寄存器 .....	85
5.6.2 中断过程 .....	86
第 6 章 汇编语言编程方法 .....	89
6.1 汇编语言程序组成 .....	90
6.1.1 汇编语言程序 .....	90
6.1.2 汇编语言程序要素 .....	92
6.2 汇编语言书写规则 .....	97
6.3 汇编语言中的表达式 .....	97
6.3.1 变量 .....	97
6.3.2 字符串表达式 .....	98
6.3.3 数字表达式 .....	100
6.3.4 逻辑表达式 .....	102
6.3.5 以 PC 为基址和以寄存器为基址的地址表达式 .....	104
6.3.6 编译时的运算顺序 .....	105
6.4 第 2 操作数 .....	105
6.4.1 第 2 操作数表达 .....	105
6.4.2 第 2 操作数规范 .....	107

## 目 录

6.5 地址的前缀和后缀 .....	107
6.6 指令可选后缀 .....	108
6.7 条件指令的应用(条件后缀) .....	109
6.7.1 条件标志的变化 .....	110
6.7.2 条件标志位 .....	110
6.7.3 条件的判断和程序的转移(条件后缀) .....	111
6.8 数据栈的应用 .....	113
<b>第7章 汇编语言工程项目 .....</b>	<b>115</b>
7.1 汇编语言启动代码 .....	115
7.1.1 标准的启动代码 .....	116
7.1.2 自编的启动代码 .....	125
7.2 汇编语言工程项目 .....	126
7.2.1 建立一个工程项目 .....	126
7.2.2 编制主程序 .....	129
7.2.3 建立一个中断处理文件 .....	133
7.2.4 建立一个子文件 .....	136
<b>第8章 Thumb-2 指令集 .....</b>	<b>138</b>
8.1 存储器访问指令 .....	139
8.2 通用数据处理指令 .....	147
8.3 乘法和除法指令 .....	155
8.4 饱和运算指令 SSAT 和 USAT .....	157
8.5 位段操作指令 .....	160
8.6 分支和分支控制指令 .....	163
8.7 其他指令 .....	167
<b>第9章 伪指令 .....</b>	<b>171</b>
9.1 概述 .....	171
9.2 符号声明类伪指令 .....	172
9.3 数据定义类伪指令 .....	174
9.4 控制程序流向的伪指令 .....	179
9.5 其他伪指令 .....	185

第 10 章 C 语言编程方法 .....	189
10.1 C 语言的两种编程方法 .....	189
10.2 创建一个 C 语言工程项目 .....	191
10.3 寄存器编程方法 .....	194
10.3.1 寄存器定义和寄存器赋值 .....	194
10.3.2 逻辑判断语句的应用 .....	198
10.3.3 Contex-M3 的位段操作在 C 语言中的应用 .....	199
10.4 工程项目组成 .....	200
10.4.1 创建和添加一个扩展名为 h 的头文件 .....	201
10.4.2 创建和添加一个中断服务程序文件 .....	201
第 11 章 混合编程方法 .....	204
11.1 嵌入式汇编语法 .....	204
11.2 参数传递 .....	206
第 12 章 通用外部端口 GPIO 和复用外部端口 AFIO .....	209
12.1 通用输入/输出端口概述 .....	209
12.2 通用 I/O 端口应用 .....	212
12.3 复用 I/O 端口 .....	218
12.4 复用功能的重新映射 .....	221
12.5 寄存器组说明 .....	225
第 13 章 模拟/数字转换器 ADC .....	227
13.1 ADC 信号源 .....	228
13.2 A/D 信号源分组 .....	228
13.2.1 概述 .....	228
13.2.2 信号源分组 .....	229
13.2.3 分组寄存器介绍 .....	231
13.2.4 分组方法举例 .....	234
13.3 使用 ADC 的几个概念 .....	235
13.3.1 采样时间及采样时间寄存器 .....	235
13.3.2 数据对齐 .....	237

# 目 录

13.3.3 校 准.....	238
13.3.4 ADC 时钟 .....	238
13.3.5 内部触发和外部触发.....	239
13.3.6 中 断.....	240
13.3.7 ADC 复位后状态 .....	241
13.4 单次转换和连续转换.....	242
13.5 扫描模式 .....	243
13.6 间断模式.....	245
13.7 ADC 的其他特性 .....	247
13.7.1 模拟看门狗.....	247
13.7.2 双 ADC 模式 .....	248
13.7.3 不同型号产品 ADC 的区别 .....	252
13.8 ADC 寄存器组 .....	253
13.9 ADC 程序实例 .....	260
<b>第 14 章 通用异步同步收发器 USART .....</b>	<b>264</b>
14.1 异步通信概述.....	264
14.2 波特率设置.....	266
14.3 数据发送 .....	267
14.4 数据接收 .....	269
14.5 异步串行通信中的中断.....	270
14.6 异步串行通信应用举例.....	271
14.7 USART 寄存器介绍 .....	273
<b>参考文献.....</b>	<b>276</b>

# 第 1 章

## 概 述

本章简单介绍 STM32F1xx 系列的特性和选型方法,介绍这个系列芯片的分类和区别。

### 1.1 STM32F1xx 系列概述

#### 1.1.1 STM32F1xx 的多个子系列

STM32F1xx 系列高性能、低价格芯片是 ST 公司的产品。这个产品系列又分为多个子系列,它们分别是 STM32F100、STM32F101、STM32F102、STM32F103、STM32F105 和 STM32F107。这些子系列的区别如下:

① STM32F100 子系列:这个系列是最初的产品,与其他系列相比主要是速度低,时钟速度是 24 MHz,其他没有大的区别。

② STM32F101 子系列:这个系列是 STM32F1xx 系列中的“基本型”产品,是一种 16 位的微处理器,也具有 32 位的性能。速度有所提高,时钟达 36 MHz。

③ STM32F102 子系列:这个系列增加了 USB 接口,称为 USB 基本型,可以满足 USB2.0 标准的要求,为实际应用增加了 USB 选择。

④ STM32F103 子系列:这个系列是 STM32F1xx 系列中的“增强型”产品,具有完全的 32 位的处理器性能、丰富的外部接口、强大的数据处理能力,适合于低电压/低功耗的应用场合。

⑤ STM32F105 子系列和 STM32F107 子系列:这个系列增加了 Internet 网络接口,称为“互连型”系列,可以满足微型设备的网络连接需要。

处理器的时钟速度是各子系列的重要区别,如表 1-1 所列。

表 1-1 STM32F1xx 子系列处理器速度的比较

型 号	处理器速度/MHz	引脚数			
STM32F100	24	48	64	100	144
STM32F101	36	48	64	100	144 36
STM32F102	48	48	64		

续表 1-1

型号	处理器速度/MHz	引脚数
STM32F103	72	48 64 100 144 36
STM32F105	72	64 100
STM32F107	72	64 100

表 1-2 列举了各子系列的性能区别,其中三相定时器可以用来控制步进电机。所有系列中所包含的功能没有列举在表内。

表 1-2 STM32F1xx 系列外设比较

型号	最大存储器/KB		USB 2.0	CAN 2.0B	以太网	三相定时器
	Flash	SRAM				
STM32F100	512	32				有
STN32F101	512	80				
STM32F102	128	16	有			
STM32F103	512	96	有	有		有
STM32F105/107	256	64	有	有	有	有

这些子系列除了上述区别外,它们的兼容性主要有:

- 封装相同的芯片引脚兼容。
- 应用程序兼容。
- 开发工具和开发环境相同。
- Flash 写入方法和工具兼容。

因为有以上兼容性,所以封装相同的芯片可以互换。

### 1.1.2 STM32F1xx 系列特点

STM32F1xx 系列包含多个子系列,这些产品不尽相同,各有特色,主要共性和特点如下:

- 采用标准的 ARM Cortex-M3 内核。
- 体积小,采用高密度的方形封装。
- 耗电低;电压低,范围是 2.0~3.6 V。
- 接口丰富,各种常用接口。
- 最高达 72 MHz 的时钟速度。
- 引脚耐压高:I/O 口可以允许 5 V 电压。
- 内嵌 Flash 程序存储器,容量从 32~1 000 KB。
- 内嵌 RAM 数据存储器,容量从 6~96 KB。

- JTAG 调试接口,通用化程度高,开发环境成熟。
- 不需要外部器件,可以独立组成系统,单片化程度高。
- 内嵌 43 个可屏蔽的中断通道(对于小容量芯片)。
- 内部包含 RC 时钟振荡器,可以省略外部振荡器。
- 成本低,可以替代低端单片机。
- 适合裸机环境(不使用操作系统)开发。

综合以上特点,STM32F1xx 系列的产品是一种高性能、低价格的产品,特别适用于中小设备的应用,尤其适合微型设备、仪表和其他电子产品的应用。它可以替代低端的单片机,以提高产品的性能和档次。

STM32F1xx 系列不适于使用操作系统,不能运行大尺寸的软件程序。芯片根据 Flash 的大小分为低密度(小容量 16~32 KB),中密度(中等容量 64~128 KB)和大密度(大容量 256 KB 以上)三个级别,中小容量产品没有外部总线接口,不支持外部存储器。

### 1.1.3 内核简介

STM32F1xx 系列微处理器的内核是一个 ARM 结构,称为 ARM Cortex-M3。这是一个 ARM 的高端产品。众所周知,ARM 是一个 32 位的微处理器结构,这个结构从 ARM1 开始逐步升级直至 ARM11,之后不再沿用以前的叫法。ARM11 的升级产品称为 ARM Cortex,因此 ARM Cortex 是一个高于 ARM11 的结构。

ARM Cortex 结构分为三个系列,分别是 ARM Cortex-A、ARM Cortex-H 和 ARM Cortex-M。STM32F1xx 系列微处理器的内核是 Cortex-M 结构,这个结构是 ARM 公司在 ARM Cortex 等级上设计的一个专用内核结构,主要应用于微型、廉价的小型设备、手提设备等,以满足低端产品的需要。

Cortex-M 结构包含四个系列,它们分别是 Cortex-M0、Cortex-M1、Cortex-M3 和 Cortex-M4,STM32F1xx 系列内核是 Cortex-M3。

Cortex-M3 具有三级流水线,完全执行 Thumb-2 指令集和传统的 Thumb 指令集,已不再兼容 ARM 指令集,不支持浮点运算指令。Cortex-M3 结构不支持 Caches 存储器。Thumb-2 指令比 Thumb 指令更加丰富,其增加了除法指令。

## 1.2 封装

STM32F1xx 作为一个广泛应用的比较成功的微处理器,有多种封装形式,可以满足不同的设计需要,其芯片封装外形图如图 1-1 所示。

其封装主要有 LQFP-48、LQFP-64、LQFP-100、BGA-100、LQFP-144 和 BGA-144 类型,也有 LQFP-36 的小封装。

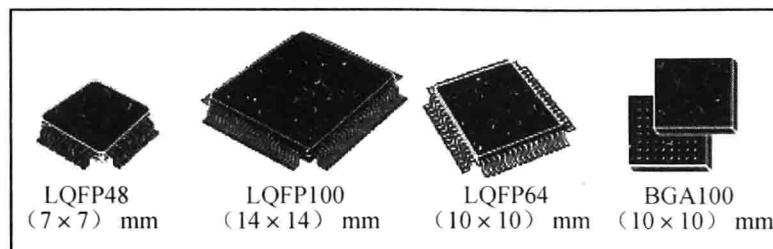


图 1-1 芯片封装外形图

引脚多的封装芯片具有较强的功能,比如 64 个引脚以上的芯片具有多达 5 个 USART 接口,同时引脚多的芯片也内嵌较大的存储器。

4

## 1.3 接 口

STM32F1xx 系列作为 ARM 的高端产品,和其他微处理器相比,尽管在体积、引脚上做了极大的削减,但大部分功能依然保留,因此接口功能很丰富。常用的接口基本都有,列举如下:

- 通用输入/输出(I/O)接口,最多可达 6 组。
- 12 位精度的 A/D 转换器。
- 标准的 JTAG 调试接口。
- 多个通用定时器和多个高级控制定时器。
- 2 个 I<sup>2</sup>C 接口。
- 多个异步/同步 USART 接口,支持局域网 LIN 和调试模式 IrDA。
- 多个同步串行 SPI 接口。
- 一个 2.0B 标准的 CAN 接口。
- 一个全速的 2.0 标准的 USB 接口。
- 微型卡 SDIO 接口。
- “互联型”型号中内嵌 Internet 网络接口。

并不是每种芯片都包含这些接口,不同的子系列所包含的接口有所不同。增强型芯片包含的接口更多一些,基本型 STM32F101 所包含的接口要少一些,而 STM32F100 就更少一些。

这些接口都具有复用功能,可以作为通用 I/O 口使用,而且大部分都具有重映射用法。重映射用法允许这些接口的默认引脚在和其他使用发生冲突时,使用另一组引脚实现这些功能。因此很多接口有两组引脚可供选用,从而使设计工作更加灵活。图 1-2 所示为 ARM 公司的技术。

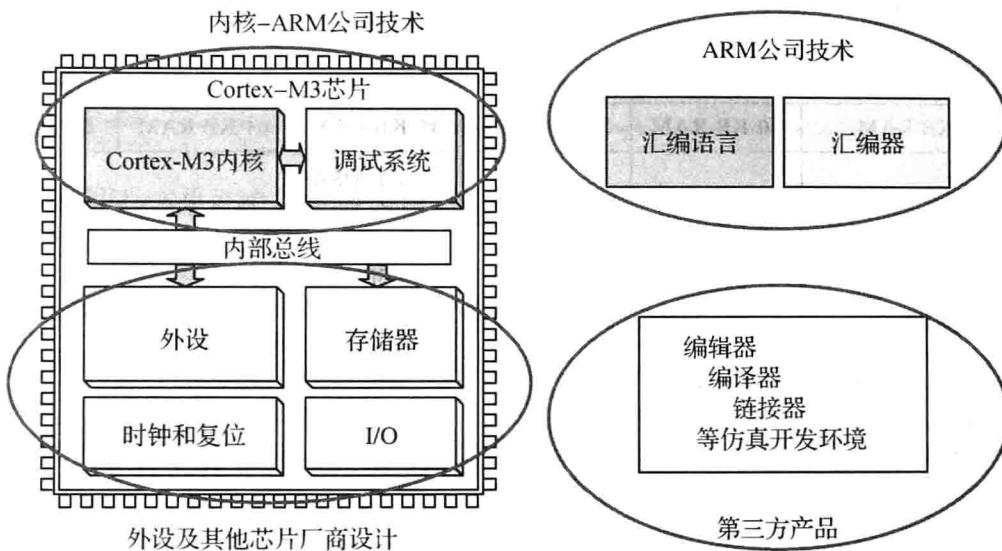


图 1-2 ARM 公司的技术

## 1.4 选型指南

STM32F1xx 系列包含多个子系列,每个子系列都有多种型号,每种型号都有自己的特点,因此有十分丰富的型号可供选择。和其他高性能的微处理器比较,STM32F1xx 内嵌了程序存储器 Flash,单片化程度比较高,因此十分有利于在小型设备、仪表上的应用。

一般选型规则:

① 根据产品任务要求确定微处理器所需要的接口种类。比如是否需要 SPI 接口,是否需要 CAN 接口或 USB 接口等。根据接口种类确定能够满足要求的芯片种类。

② 根据产品任务确定所需要的通用 I/O 口数量,由此进一步确定能够满足要求的芯片类型。

表 1-3 是 STM32F103 系列产品性能选型表,主要列举性能和引脚以及内部存储器之间的关系。可以通过这个表,根据所要求的性能选定芯片的引脚数和内存容量。

表 1-3 STM32F103 系列产品性能选型表

引脚数	存储器					
	32 KB 闪存	64 KB 闪存	128 KB 闪存	256 KB 闪存	384 KB 闪存	512 KB 闪存
	10 KB RAM	20 KB RAM	20 KB RAM	48 KB RAM	64 KB RAM	64 KB RAM
144				5 个 USART 4 个 16 位定时器、2 个基本定时器 3 个 SPI, 2 个 I <sup>2</sup> S, 2 个 I <sup>2</sup> C USB、CAN、2 个 PWM 定时器 3 个 ADC、1 个 DAC、1 个 SDIO FSMC(100 和 144 脚)		
100		3 个 USART 3 个 16 位定时器 2 个 SPI, 2 个 I <sup>2</sup> C USB、CAN				
64	2 个 USART 2 个 16 位定时器 1 个 SPI, 1 个 I <sup>2</sup> C USB、CAN	1 个 PWM 定时器 1 个 ADC				
48						
36	1 个 PWM 定时器 1 个 ADC					

表 1-4 是 STM32F103 系列产品型号和引脚数对照表, 可以通过这个表, 根据引脚数和内存容量确定所需要的产品型号。

表 1-4 STM32F103 系列产品型号和引脚数对照表

类别	STM32F103Cx			STM32F103Rx			STM32F103Vx			STM32F103Zx		
闪存/KB	256	384	512	256	384	512	256	384	512	256	384	512
RAM/KB	48	64		48	64		48	64		48	64	
封装	LQFP48			LQFP64			LQFP100,BGA100			LQFP144,BGA144		

图 1-3 是 STM32F103 系列产品订货代码表达法, 要确定自己所选定的型号, 准确表达型号代码。图中列举 13 位代码, 后面的代码一般可以不考虑, 主要表达芯片的装箱形式和每个最小包装的数量。

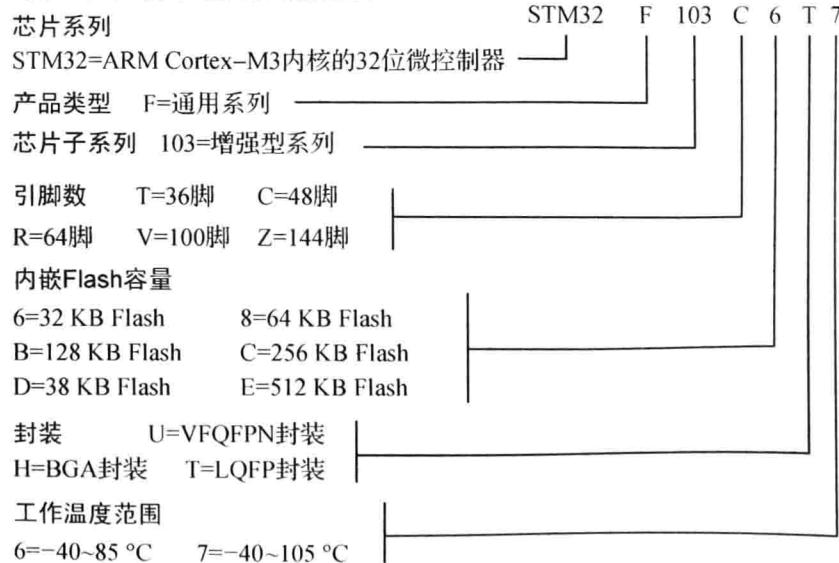


图 1-3 STM32F103 系列产品订货代码表达法